

中华人民共和国
建设用地规划许可证

地字第 330111201800011 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关
日期 二〇一八年三月二十一日

用地单位	杭州中芯晶圆半导体股份有限公司
项目名称	半导体大硅片（200mm、300mm）项目
批准用地机关	
批准用地文号	
用地位置	大江东
用地面积	139112平方米
土地用途	工业
建设规模	
土地取得方式	
附图及附件名称	
图号：〈无图号〉	历次发证日期：
存：JDC320180022	2018年03月21日 原证
JD3201800033	

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。